

推動臺灣成為亞洲高階製造中心與半導體先進製程中心

行政院長蘇貞昌今(2)日在行政院會聽取經濟部「推動臺灣成為亞洲高階製造中心與半導體先進製程中心」報告，宣示政府將打造台灣成為亞洲「高階製造、半導體先進製程」中心，帶領產業轉型，爭取國內外廠商在台投資，發揮優勢、厚植技術能量，完整產業供應鏈，為台灣長遠的經濟發展打下厚實基礎。

經濟部表示，受到美中貿易衝突、武漢肺炎疫情影響，全球供應鏈正加快重組，此外，世界各國對中國製造存有極大的資安疑慮，因此有越來越多高階產品選擇移回臺灣，政府將掌握時機，推動臺灣成為「亞洲高階製造中心」，經濟部將結合產業公協會力量，引導廠商導入 AI、5G 智慧化科技，推動產業智慧化、數位轉型並發展創新應用解決方案，加快腳步實現產業鏈智慧化，讓臺灣產業成為全球供應鏈中最值得信任的夥伴之一。

經濟部指出，另一方面，臺灣半導體產業以專業分工與群聚效益等優勢獨步全球，2019 年臺灣半導體產業產值已達 2.7

兆新臺幣，居全球第 2 名關鍵地位。

經濟部表示，根據統計，2019 年我國半導體設備需求約達新臺幣 5,130 億元，占了全球需求 28%；半導體材料需求則達新臺幣 3,306 億元，也占了全球 22%。我國半導體廠商近年來投資超過新臺幣 2.72 兆，政府也將建立更完整半導體產業聚落，形塑臺灣成為「半導體先進製程中心」，藉此機會吸引更多半導體設備及材料等外商來台投資，同時擴大國內業者與外商合作，落實材料及設備供應鏈的自主化與國產化，並達成 2030 年半導體產值 5 兆新臺幣的目標。

經濟部強調，過去臺灣產業擅長於硬體製造，並且專注在提高硬體的生產效率。未來我們不會滿足於擔任高效率製造者的角色，還要運用智慧科技推動產業轉型，將從零組件製造，邁向軟硬整合、系統輸出，成為智慧解決方案的提供者，推動產業智慧化、數位轉型並發展創新應用解決方案，走向高階製造業，實現產業鏈智慧化，讓臺灣產業從 CP(cost performance)轉變為 TP(trust performance)。